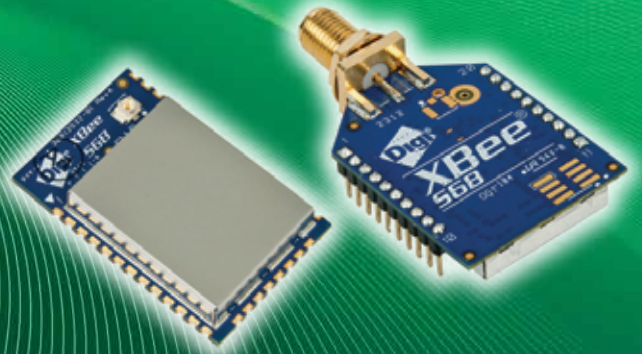


XBee® Wi-Fi

組み込みWi-Fiモジュール for OEM

組み込みWi-Fiモジュール「XBee Wi-Fi」は、フレキシブルなXBeeのハードウェアとソフトウェアのフットプリントで、超低出力の802.11b/g/n通信を提供します。



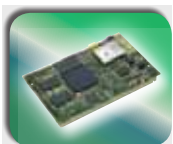
Overview

XBee Wi-Fi組み込みRFモジュールは、シンプルなシリアル to IEEE 802.11のコネクティビティを提供します。ワイヤレスデバイスネットワークの低出力/低コスト要件を802.11の実績のある基盤で満たすことによって、XBee Wi-Fiはエネルギー管理、プロセスおよびファクトリオートメーション、ワイヤレスセンサネットワーク、インテリジェントな資産管理、その他の新たなワイヤレスのチャンスを生み出します。容易なプロビジョニングの手法およびネイティブなDevice Cloudコネクティビティを搭載したXBee Wi-Fiモジュールは、開発者にこの上なく速いIP to DeviceおよびDevice to Cloudの機能を提供します。

XBeeモジュールは、開発者に大きな柔軟性を提供し、表面実装(SMT)およびスルーホールフォームファクタが利用可能です。XBee Wi-Fi は、他のXBeeモジュールとフットプリントを共有します。これにより、異なるXBeeのテクノロジーを相互にドロップ・イン(置くだけ)で置き換えることができます。

XBeeファミリのメンバーとして、XBee Wi-Fiはハードウェアとソフトウェアを融合し、完全なモジュラーソリューションを実現しています。XBee Wi-Fiモジュールは、既存の802.11インフラストラクチャのアクセスポイントと通信するように設計されています。開発者は、先進のコンフィギュレーションオプションにATおよびAPIコマンドを使用することができます。

関連アイテム



Wi-Fi System-on-Modules



Wi-Fi Modules



Device Cloud Solutions



Wireless Serial Servers

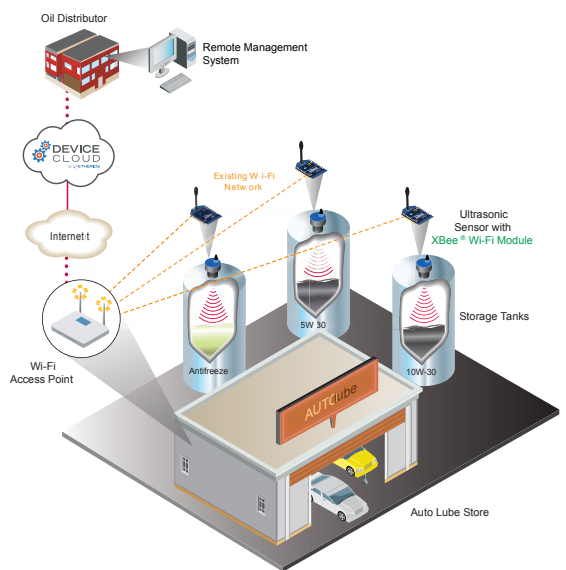


XBee Modules



Development Kits

アプリケーションハイライト



機能と特徴

- ・ データ収集やデバイスマネジメントを実現するネイティブなDevice Cloudインテグレーション
- ・ ハードウェアおよびソフトウェアが揃ったモジュールは、既存の802.11b/g/n (Wi-Fi)インフラストラクチャに容易に接続可能
- ・ 共通のXBeeフットプリントにより、OEMは1つのフットプリントでさまざまなワイヤレスプロトコルをサポート可能
- ・ 柔軟なSPIおよびUARTシリアルインターフェース
- ・ 表面実装(SMT)およびスルーホールの両フォームファクタが利用可能
- ・ <6μAパワーダウン電流により低電力スリープアプリケーションに対応
- ・ 最大72Mbpsの無線通信データレート
- ・ Soft APおよびWi-Fi Protected Setup (WPS)などのシンプルなプロビジョニング手法を含む



機能

シリアルデータインターフェース	UART (最大1 Mbps)、SPI (最大6Mbps)
コンフィグレーション方法	API または AT コマンド
周波数帯域	ISM 2.4 GHz
ADC入力	12ビット×4
デジタルI/O	10
フォームファクタ	スルーホール、表面実装(SMT)
アンテナオプション	スルーホール: PCB (組込み)、U.FL、RPSMA、内蔵ワイヤ SMT: PCB (組込み)、U.FL、RF Pad
動作温度	-30°C ~ +85°C
外形寸法 (L×W)	スルーホール: 2.438 cm×3.294 cm SMT: 2.20cm×3.40cm×0.30cm

ネットワークおよびセキュリティ

セキュリティ	WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP
チャンネル	13チャンネル

無線LAN

規格	802.11b/g/n
データレート	1 Mbps ~ 72Mbps
変調	802.11b: CCK, DSSS 802.11g/n: OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
送信出力	最大+ 16 dBm
受信感度	-93 ~ -71 dBm

電力条件

供給電圧	3.14 ~ 3.46V
送信電流	最大309mA
受信電流	100 mA
パワーダウン電流	< 6 μ A @ 25°C

規制認可

FCC (アメリカ)	○
IC (カナダ)	○
CE / ETSI (ヨーロッパ)	○
C-TICK (オーストラリア)	○
Telec (日本)	○
Anatel (ブラジル)	申請中

M2Mネットワークを実現するための製品とテクノロジーを提供します

ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F

TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp

www.digi-intl.co.jp

BUY ONLINE • www.digi-intl.co.jp



© 2011-2013 Digi International Inc.

●記載した仕様は予告なく変更する場合があります。●Digi, Digi International, Digiロゴ, DigiMesh, iDigi, iDigi Device Cloud, XBeeは、Digiインターナショナルの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。●ARMはARM社の登録商標です。●その他のすべての社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。●製品の仕様などの情報は予告なく変更する場合があります。

2013/05(改)